

2026 增長引擎更加多元化

編輯部

2026 年全球半導體產業將告別 2025 年由 AI 與資料中心主導的單一增長模式，邁入均衡成長與韌性發展的新階段，多家企業高管圍繞產業趨勢、技術創新、供應鏈佈局、市場機遇等核心議題分享了洞察。

一、產業整體趨勢：均衡復蘇與多元增長

產業增長動能從集中於 AI 與資料中心，擴散至多個領域：成熟制程經庫存修正後上半年將強勁反彈，應用於 AI 伺服器的高頻寬記憶體 (HBM) 需求持續看漲；終端市場全面復蘇，汽車、工業市場復蘇跡象明顯，消費電子市場隨成本消化趨於穩定，推動產業擺脫單一依賴，形成健康均衡的生態。

二、供應鏈格局：應對地緣挑戰，強化韌性與區域化

地緣政治緊張帶來的出口管制、關稅等挑戰，促使企業將供應鏈安全與穩定列為戰略重點。核心舉措包括打破單一依賴，推行地理多元性佈局與多源採購策略 (如 Microchip 提

升日本產能、Nordic 採用雙代工廠模式)；產業形成以中國為核心和中國以外地區運作的兩大供應鏈格局，區域化趨勢凸顯但未出現全面“脫鉤”，客戶仍以產品品質與供應穩定性為優先。此外，供應鏈“網路中的網路”模式興起，整合實體、資料與人才網路，應對關鍵材料“長尾市場”的區域化採購需求。

三、技術創新：AI 驅動轉型，多領域突破

AI 技術演進：AI 從雲端向終端遷移，實體 AI (邊緣 AI) 全面興起，TinyML、嵌入式 AI 應用普及，企業需構建整合連接、感知與推論的模組化架構；AI 的核心價值回歸生產力提升與可持續商業成果，企業兼顧 AI 佈局與核心技術多元化以規避風險。

連接與運算技術：高速互連技術升級，224Gbps PAM-4 速率方案普及並預留 1.6T 升級路徑；共封裝光學 (CPO) 成為解決 AI 架構 GPU 互連瓶頸的焦點；衛星物聯網 (NTN)、雙頻 Wi-Fi 6、藍牙 LE 通道探測

等技術拓展應用場景。

配套技術革新：液冷技術成為高性能伺服器熱管理主流；48V 架構將成為 AI 資料中心與新世代車輛的通用電源效率標準；模組化、微型化解決方案跨產業普及，適配穿戴設備、工業自動化等空間受限場景。

四、市場機遇與企業戰略

低功耗物聯網、可穿戴設備、智慧家居、工業自動化、醫療科技、航太、電動車、AR/VR 等領域持續擴容，藍牙 LE 年出貨量預計 2025-2029 年從 53 億台增至 77 億台。產業競爭焦點將集中於技術創新與供應鏈智慧整合，企業需以模組化架構、多元佈局與長期人才投資，應對市場變革與風險。

CTA